**2023年度苏州工业园区集成电路产业发展专项资金申报书**

（2.5 支持场景应用）

1. 项目基本情况

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 |  |
| 社会信用代码 |  |
| 单位地址 |  |
| 法定代表人 |  | 联系电话 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 注册时间 |  | 注册资本（万元） |  |
| 企业介绍及主营业务概述（300字以内） |  |
| 财务运营状况 | **指标/年份** | **2021年** | **2022年** |
| 营业收入（万元） |  |  |
| 营业收入增长率（%） |  |  |
| 企业研发投入（万元） |  |  |
| 研发投入占比（%） |  |  |
| 企业净利润（万元） |  |  |
| 专利数量（个） |  |  |
| 产品/服务使用金额（万元） | 应用场景 | 应用企业 | 2022年产品/服务使用金额（万元） |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 2022年园区内产品/服务使用总额（万元）： |  |

1. 产品或服务情况
2. **产品或服务内容介绍**
3. **创新亮点及社会经济效益**
4. **适用场景（每类场景分开介绍）**
5. **下一步开发及推广计划**
6. 产品或服务应用合同及发票清单

（一）合同清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 合同名称 | 合同日期 | 应用单位（非关联方） | 合同金额（万元） | 对应场景 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 合同总额（万元）： |  |

（二）发票清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 开票时间 | 开票方 | 发票编号 | 对应合同序号 | 开票金额（万元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 开票总额（万元）： |  |